

2022年11月10日

一般社団法人 電子情報技術産業協会
実装技術標準化専門委員会
委員長 二宮 良次
サーマルマネジメント標準化グループ
主査 福江 高志

「電子部品が実装されたプリント基板に関する熱設計・熱対策セミナー」のご案内
〔JEITA 技術レポート (ETR-7032, 7033, 7034) ガイダンス〕

JEITA 実装技術標準化専門委員会 サーマルマネジメント標準化グループでは、部品実装環境の変遷により発生した、熱設計のパラダイムシフトに対する新しいプラットフォームの構築を目指し、基板実装型部品の温度規定、温度計測、基板放熱に関連した標準化に向けた活動を進めています。

さて、当グループでは、新しい温度管理のプラットフォームの土台となるガイドラインおよびガイダンスを、JEITA 技術レポート (ETR-7032, 7033, 7034) として 2020 年度に発行いたしました。これらの内容についてご紹介し、電子部品が実装されたプリント基板に関する熱設計や熱対策について考えるセミナーを、オンラインにて実施する運びとなりました。

関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜り、各社の事業にお役立て頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

日 時：2022年12月5日(月) 13:00~16:30

■ 申込サイト：<https://www.jeita.or.jp/form/custom/206/form>

■ 主 催：実装技術標準化専門委員会

■ 開催形態：オンライン会議システム (WebEX)

■ 参加費：無料

■ 申込方法：上記申込サイトからお申し込み下さい。

資料及びオンライン会議 (WebEX) 参加案内は、開催 3 日前を目途にご連絡致します。

■ 申込期限：**2022年11月30日(水)**

■ その他：セミナーご参加の方に、技術レポート (ETR-7032, 7033, 7034) の通常の価格の 30%引きで優待販売をいたします (各限定 20 部)。

■ 事務局：一般社団法人 電子情報技術産業協会 事業推進部 (布川・澤田)

E-mail : tsc4@jeita.or.jp

■プログラム

〔司会：福江 高志 サーマルマネジメント標準化グループ主査 金沢工業大学〕

【はじめに】

13:00-13:20 「実装技術の変遷により発生した熱設計のパラダイムシフトについて」

（グループ活動趣旨のご紹介，技術レポートの位置づけ）

福江 高志 サーマルマネジメント標準化グループ主査
金沢工業大学

【各技術レポートのご紹介】

13:20-14:00 「ETR-7032：電気・電子部品の使用温度に関する現状の温度規定及び課題に対する
ガイドライン」

内田 昌宏 サーマルマネジメント標準化グループ
部品使用環境温度規定サブグループリーダー，ローム（株）

（休憩）

14:15-14:55 「ETR-7033：電子部品の温度測定方法に関するガイダンス」

梶田 欣 サーマルマネジメント標準化グループ
温度測定サブグループリーダー，名古屋市工業研究所

14:55-15:35 「ETR-7034：基板放熱型部品を実装したプリント基板の熱設計ガイドライン」

畑 陽介 サーマルマネジメント標準化グループ
基板放熱ガイドライン検討サブグループ，ブラザー工業（株）
藤田 哲也 サーマルマネジメント標準化グループ
基板放熱ガイドライン検討サブグループ，図研テック（株）

15:35-15:45 クロージング

【技術相談会】

15:45-16:30 技術レポートや熱設計・熱対策に関する技術相談会・質疑応答

※ プログラムは変更になる場合がありますので，予めご了承下さい。